

SP240系列

SP240系列是高温用无铅锡膏，可以适用于SMT工程，是可以在高温的回流焊条件下取得较好测试结果的产品

应用

- 适用于 SMT 工程和 Die attach 工程以及需要在高温环境下进行操作的半导体行业的设备上。
- Printing 工程, Dotting 工程, Dispensing 工程的应用上都能达到最佳化。

特点 & 优势

- 使用 Halogen Free 的助焊剂。
- 连续印刷时 (Printing) ，有着非常连贯的印刷性能。
- 高温回流焊情况下 (Reflow) 也有良好的耐热性。
- 有着非常好的浸湿性 (Wetting performance) 以及最低化的空洞率。
- 印刷后 (Printing) Slump 的现象较少，焊接的可靠性更强。
- 锡珠 (Solder ball) 发生的现象较少。

产品信息

合金：Sn3.0Ag0.5Cu / Sn0.7Cu (可以根据客户的要求添加金属合金)

锡粉粒径：Type 4 (20~38um), Type 5 (15~25um), Type 6 (5~15um)

包装方式：可以根据客户需要定制。

物理性特性

Spec.	Unit	Value	Measured
Color	-	Gray	Visual
Activity Level	-	ROLO	IPC J-STD-004B
Specific gravity	-	7.4	-
Thixotropic Index (TI)	-	0.4~0.7	MALCOM
Viscosity @ 25°C	Pa.S	LV (40~80) MV (80~140) HV (140~ 230)	MALCOM(10rpm)
Thermal Conductivity	W/mK	63	Laser Flash Diffusivity

- 可以根据客户的工艺条件调整(金属含量及粘度)

作业时间

区分	单位	Value	备注
Open time	Hour	< 12hrs	-
Work life	Hour	< 8hrs	-
Shelf life	Month	6month	0-10°C

使用方法

1) 解冻

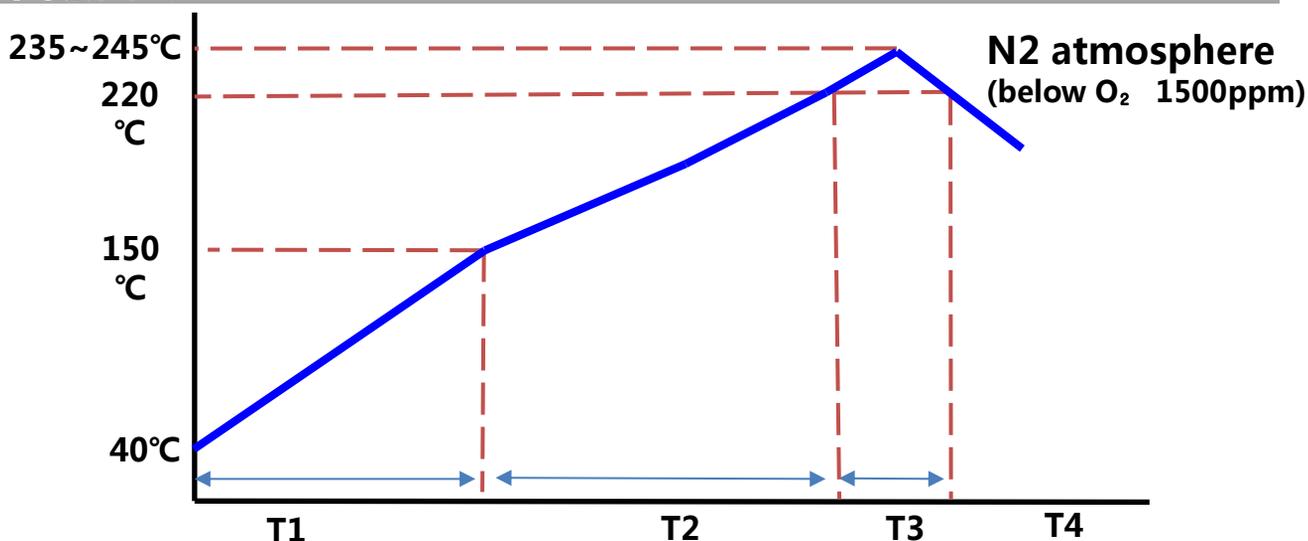
- 作业前2个小时从冷冻库里拿出产品，在未开封的状态下进行解冻。
介于冷冻状态下开封时，有结霜的现象可能会成为导致锡珠发生的原因。
- 在和常温相似的温度下(20~25°C)开封并使用。

2) 搅拌

- 推荐手动搅拌(2min ~ 3min)
请注意，过度搅拌的话会使锡膏发生物理变化。
- 机器搅拌条件如下所示。

条件(Spec.)	速度(RPM)	时间(Sec.)
自动搅拌(Jar)	500	15~20

回流曲线



Zone	T1	T2	T3	T4	Peak Temp.
Type	Raising	Preheat 1	Soldering	Cooling	240+/-3°C
Temp(°C)	40~150	150~220	220°C以上	220°C以下	
Time(sec)	1~2°C/sec	60~120	40~90	2°C/sec	